

Transfer Molding System

Model Y1R1060



The origin of transfer molding system with modular concept

モジュール方式を採用した トランスファーマールド装置の原点

- 長年実績のある高い信頼性と安定性のトランスファモルディング装置
- 60トンのクランプ能力
- プレスモジュールの増減による生産数量の変化への対応

製品情報



日本語



SPECIFICATION

Items			Unit	Description			
モデル			—	Y1R1060			
ワークタイプ			—	基板・リードフレーム			
ワークサイズ	長さ		mm	100—260			
	幅		mm	15—75			
樹脂	径		mm	φ 13, 14, 16, 18, 20			
	長さ		mm	14.3—35.0			
マシンタイム			sec	Approximately 20			
外形寸法	プレス数		module	1	2	3	4
	スタックマガジン仕様	幅	mm	1,770	2,310	2,850	3,390
		奥行き	mm	1,520	1,520	1,520	1,520
		高さ	mm	1,800	1,800	1,800	1,800
	スリットマガジン仕様	幅	mm	1,770	2,310	2,850	3,390
		奥行き	mm	1,860	1,860	1,860	1,860
高さ		mm	1,800	1,800	1,800	1,800	
重量	スタックマガジン仕様		ton	3.8	5.7	7.6	9.5
	スリットマガジン仕様		ton	4.1	6.0	7.9	9.8
成形取り数			workpiece	2	4	6	8
インプットマガジンスペース			mm	300			
アウトプットマガジン数（スタックマガジン仕様）			pcs	2			
アウトプットマガジンスペース（スリットマガジン仕様）			mm	300			
クランプ出力			kN／(tf)	196.0—588.0／20.0—60.0			
トランスファ出力			kN／(tf)	2.9—31.4／0.3—3.2（2圧設定）			
品種切替え方式			—	キット交換式			
搭載可能金型			—	S, M, L			

・上記数値は当社標準機の場合です。
・改良のため仕様を変更する事があります。
・特殊システム仕様についてはご相談ください。



本社

〒601-8105
京都府京都市南区上鳥羽上調子町 5 番地

お問い合わせ先



TOWA (当社のハウスマーク)、 はTOWA株式会社の商標または登録商標です。

海外販売拠点

中国
TOWA (Shanghai) Co., Ltd.
台湾
TOWA Taiwan Co., Ltd.
韓国
TOWA Korea Co., Ltd.
シンガポール
TOWA Asia-Pacific Pte. Ltd.
マレーシア
TOWA Malaysia Sales & Services Sdn. Bhd.
タイ
TOWA THAI COMPANY LIMITED

フィリピン
TOWA Semiconductor Equipment Philippines Corp.
インド
TOWA SEMICONDUCTOR INDIA PRIVATE LIMITED
ドイツ
TOWA Europe GmbH
オランダ
TOWA Europe B.V.
アメリカ
TOWA USA Corporation

20250401-004-HQ